

頡邦科技(股)公司簡介

公司名稱	頡邦科技股份有限公司				
負責人	吳非艱	統一編號	16130009		
聯絡人	范小姐	部門	人力招募部		
聯絡電話	(03)567-8788 #22405	傳真	(03)567-8690		
公司地址	(總部) 新竹市力行五路三號				
公司官網	http://www.chipbond.com.tw				
E-mail	christinefan@chipbond.com.tw				
公司簡介	<p>頡邦科技公司成立於 1997 年 7 月，為利基型的半導體封裝與測試服務供應商，主要業務為提供顯示器驅動 IC 後段封裝及測試代工服務，其中驅動 IC 封裝包括前段之金凸塊製程與後段之 TCP 及 COG 封裝，及覆晶封裝並包括前段之錫鉛凸塊製作。</p> <p>2010 年合併案後，在金凸塊、Wafer test、COF、COG 的產能為全球第一大，目前為全球第一大驅動 IC 封裝公司。</p>				
營業項目	<p>◎營業項目</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 金屬凸塊(Wafer Bumping Service) (2) 金凸塊(Gold Bump) (3) 錫鉛凸塊(Solder Bump) (4) 捲帶式軟板封裝(TCP) (5) 捲帶式薄膜覆晶(COF, Chip on Film) (6) 覆晶(Flip Chip) (7) 玻璃覆晶封裝(COG, Chip on Glass) <p>◎產品營收比重分別為：</p> <p>8 吋金凸塊約佔 29%、12 吋金凸塊約 12%、晶圓測試約佔 1 成，COF(捲帶式覆晶薄膜封裝)約佔 22%、COG(玻璃覆晶封裝)約佔 10%、Tape(COF 載板)約佔 16%。COF 因可重封，其主要應用於大尺寸面板，COG 則多用在小尺寸面板。</p> <p>◎以應用分：</p> <p>TV 佔約 45%、手機佔約 25%、平板電腦佔約 10%、PC 及 NB 佔約 25%。</p>				
資本額	65 億元	年營業額	204 億元	員工人數	6,000 人(台灣)